

## 第 10 回 電子デバイス実装研究委員会プログラム

日時:平成 27 年 7 月 14 日(金) 10:30～17:00

場所:日本橋ライフサイエンスビルディング 2 階 201 大会議室 (東京都中央区)

時間	題 目	講 演 者
10:30～ 12:00	司会 西川 宏 (大阪大学)	
	『はんだフラックス由来の臭素が関与したSn <sub>0</sub> ウイスカの発生とリスク予測』 (45 分)	(株)村田製作所 ○斎藤 彰
	『銀含有量を変化したはんだ材料の温度サイクル信頼性』 (45 分)	(株)東芝 ○山部 光治
12:00～ 12:50	昼 食 休 憩	
12:50～ 13:00	委 員 会 議 事	
13:00～ 15:15	司会 荻谷 義治 (芝浦工業大学)	
	『平衡状態図と凝固組織 ー特にSn基共晶合金についてー』 (45分)	防衛大学校 ○江阪 久雄
	『SEM-EDSを用いた加熱/冷却にともなう合金のIn-situ観察および分析事例』 (45分)	日本電子(株) ○中畠 香織、森田 正樹、 新美 大伸、三平 智宏、鈴木 俊明
	『高機能光マイクロシステム・センサを実現する低温接合技術の最新動向』 (45分)	東京大学 ○日暮 栄治
15:15～ 15:30	休 憩	
15:30～ 17:00	司会 木村 裕二 ((株)村田製作所)	
	『MEMSガスセンサ』 (45 分)	富士電機(株) ○鈴木 卓弥
	『パワーデバイスパッケージの放熱特性評価と不良解析』 (45 分)	(株)東レリサーチセンター ○遠藤 亮、渡邊 淳一、内田 智之、 杉江 隆一

( )内時間は、質疑応答時間を含む

※ プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。

平成 27 年 7 月 14 日 火曜日